(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願 分介/后书

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2003年12月31日(31.12.2003)

PCT

(10) 国際公開番号

(51) 国際特許分類7:

WO 2004/001828 A1

H01L 21/304, 21/306

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/007849

(22) 国際出願日:

2003年6月20日(20.06.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

1

特願2002-181151

2002年6月21日(21.06.2002)

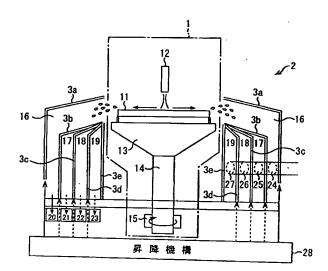
(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について):サイ ペック株式会社 (SIPEC CORPORATION) [JP/JP]: 〒 112-0012 東京都 文京区 大塚 3-1 1-6 ニッセイ大 塚3丁目ビル7階 Tokyo (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 松澤 実 (MAT-SUZAWA, Minoru) [JP/JP]; 〒112-0012 東京都 文京 区 大塚 3-1 1-6 ニッセイ大塚 3 丁目ビル 7 階 サイペック株式会社内 Tokyo (JP). 長阪 道雄 (NA-GASAKA, Michio) [JP/JP]; 〒112-0012 東京都 文京区 大塚3-11-6 ニッセイ大塚3丁目ビル7階 サイ ペック株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 國分 孝悦 (KOKUBUN, Takayoshi); 〒170-0013 東京都 豊島区 東池袋 1 丁目 1 7番 8号 池袋 TGホーメストビル5階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): CN, KR, US.

[続葉有]

(54) Title: SUBSTRATE PROCESSING DEVICE AND SUBSTRATE PROCESSING METHOD

(54) 発明の名称: 基板処理装置及び基板処理方法



28...LIFTING MECHANISM

(57) Abstract: In a substrate processing device, a substrate (11) to be processed held by a substrate chuck (13) is rotated and different types of processing liquids are supplied on the substrate (11) to be processed. The device has collection vessels (16-19) provided so as to collect by type the processing liquids scattered by rotation means (15) from the substrate (11) to be processed. To collect a processing liquid by any one of the collection vessels, a lifting mechanism (28) is driven so that the liquid is collected with the entrance of only that collection vessel opened and that the processing liquid to be collected is not mixed into the other collection vessels.

(57) 要約: 基板チャック部(13)で保持された被処理基板(11)を回転させて、被処理基板(11)上に複数 の処理液を供給し、回転手段(15)により被処理基板(11)から飛散した処理液をその種類毎に回収するよう に設けられた複数の回収槽(16~19)を有しており、

/続葉有/